



ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORPORATION LIMITED

上海先進半導體製造股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股份代號：03355)

**2008 年中期初步業績公告**  
**截至 2008 年 6 月 30 日止六個月**

中期業績

上海先進半導體製造股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)將截至2008年6月30日六個月的未審數中期業績公佈如下：

損益表

截至2008年6月30日止六個月

		截至2008年 6月30日止 三個月 (未審數) 附註 人民幣千元	截至2008年 6月30日止 六個月 (未審數) 人民幣千元	截至2007年 6月30日止 三個月 (未審數) 人民幣千元	截至2007年 6月30日止 六個月 (未審數) 人民幣千元
營業額	4	260,584	518,892	271,189	579,452
銷售成本		(255,697)	(502,840)	(291,052)	(603,106)
毛利／(負毛利)		4,887	16,052	(19,863)	(23,654)
銷售及市場推廣開支		(2,061)	(3,248)	(2,278)	(4,250)
行政開支		(18,221)	(38,024)	(20,069)	(36,245)
研發成本		(2,021)	(8,800)	(9,016)	(20,294)

		截至2008年 6月30日止 三個月 (未審數) 人民幣千元	截至2008年 6月30日止 六個月 (未審數) 人民幣千元	截至2007年 6月30日止 三個月 (未審數) 人民幣千元	截至2007年 6月30日止 六個月 (未審數) 人民幣千元
附註					
經營業務虧損		(17,416)	(34,020)	(51,226)	(84,443)
其他收入	5	45,325	48,427	8,404	15,936
其他費用	5	(3,497)	(10,590)	—	—
融資成本	6	(4,522)	(10,391)	(10,593)	(24,161)
除所得稅前之溢利／ (虧損)	6	19,890	(6,574)	(53,415)	(92,668)
所得稅退款	7	—	—	17,969	19,713
淨溢利／(虧損)		19,890	(6,574)	(35,446)	(72,955)
股息	8	—	—	—	—
本公司普通股股東 每股盈利／(虧損) — 基本	9	1.30分	(0.43)分	(2.31)分	(4.76)分

資產負債表  
2008年6月30日

		2008年 6月30日 (未審數) 人民幣千元	2007年 12月31日 (已審數) 人民幣千元
	附註		
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		818,346	926,022
在建工程		2,122	3,101
土地租賃預付款		34,698	35,085
無形資產		12,609	14,530
非流動資產總值		<u>867,775</u>	<u>978,738</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		175,883	234,507
應收貿易賬款及應收票據	10	113,079	83,778
預付款項、按金及其他應收款項		16,380	42,108
應收關聯公司款項		29,848	35,812
現金及現金等價物		229,797	206,995
流動資產總值		<u>564,987</u>	<u>603,200</u>
資產總值		<u>1,432,762</u>	<u>1,581,938</u>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款	11	115,135	171,680
應計負債及其他應付款項		71,086	81,056
應付關聯公司款項		9,218	4,165
計息借款		269,151	350,291
流動負債總值		<u>464,590</u>	<u>607,192</u>
流動資產／(負債)淨值		<u>100,397</u>	<u>(3,992)</u>
<b>非流動負債</b>			
遞延稅負債		222	222
資產淨值		<u>967,950</u>	<u>974,524</u>
<b>股本及儲備</b>			
註冊及繳足股本		1,534,227	1,534,227
儲備		(566,277)	(559,703)
股東權益		<u>967,950</u>	<u>974,524</u>

## 權益變動表

截至2008年6月30日止六個月

	截至2008年 6月30日止 六個月 (未審數) 人民幣千元	截至2007年 6月30日止 六個月 (未審數) 人民幣千元
註冊及繳足股本		
普通股每股面值人民幣1.00元		
期初及期末餘額	<u>1,534,227</u>	<u>1,534,227</u>
資本儲備		
期初及期末餘額	<u>205,363</u>	<u>205,363</u>
法定盈餘公積		
期初餘額和期末餘額	<u>19,353</u>	<u>19,353</u>
累計虧損		
期初餘額	(784,419)	55,780
本期虧損	<u>(6,574)</u>	<u>(72,955)</u>
期末餘額	<u>(790,993)</u>	<u>(17,175)</u>
儲備	<u>(566,277)</u>	<u>207,541</u>
股東權益	<u>967,950</u>	<u>1,741,768</u>

簡明現金流量表

截至2008年6月30日止六個月

	截至2008年 6月30日止 六個月 (未審數) 人民幣千元	截至2007年 6月30日止 六個月 (未審數) 人民幣千元
經營業務現金流入淨額	109,881	38,481
投資活動之現金流出淨額	(5,939)	(1,492)
融資活動現金流出淨額	(81,140)	(371,439)
現金及現金等價物增加／(減少)淨額	22,802	(334,450)
現金及現金等價物之期初餘額	206,995	396,987
現金及現金等價物之期末餘額	<u>229,797</u>	<u>62,537</u>
現金及現金等價物結餘分析		
現金及銀行存款	162,735	32,207
未抵押定期存款	67,062	30,330
	<u>229,797</u>	<u>62,537</u>

## 簡明財務報表附註

2008年6月30日

### 1. 公司資料

上海先進半導體製造股份有限公司(以下簡稱「本公司」)為按照中國《外商投資企業法》於1988年10月4日在中國人民共和國成立之外商投資企業，經營期限30年，從1988年10月4日至2019年10月3日。

於2004年3月2日，本公司通過發行1,109,080,000股每股價值為人民幣1.00元繳足之股本重新註冊為外商投資股份有限公司，經營期限為不定期。於2006年4月7日，本公司的H股在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)成功上市。

本公司的註冊所在地及主要經營地位於中國上海虹漕路385號(郵編200233)。

本公司主要從事5寸、6寸和8寸晶圓的生產製造和銷售。

### 2. 呈報基準

本未審中期簡明財務報表乃根據聯交所證券上市規則附錄十六之適用披露要求以及國際會計準則理事會頒佈之國際會計準則第34號《中期財務報告》編製。

本公司按持續經營原則編製2008年末審中期簡明財務報表，因為本公司有足夠來自營業活動現金流量及足夠未動用的銀行信貸來承兌自2008年6月30日起計至少十二個月期間內到期之財務責任。

本未審中期簡明財務報表並非包括所有年度報告中所要求的資訊和披露，因此須與截至2007年12月31日止年度的財務報告一併進行閱讀。

本公司在編製本未審中期簡明財務報表所採納的會計政策以及計算方法與本公司於截至2007年12月31日止的年度財務報表所採納者一致，除在其2007年度財務報表之重大會計政策中披露外，該等未審中期簡明財務報表是按照國際財務報告準則之歷史成本法編製。

## 新發佈但還未生效之國際財務報告準則的影響

本公司還未採納下述新發佈及修訂對本公司適用之國際財務報告準則，其已發佈但未生效。以下國際財務報告準則將對自2009年1月1日或以後起開始之會計年度生效：

國際會計準則第1號(修訂版)	財務報表列報
國際財務報告準則第8號	經營分部
國際會計準則第23號(修訂版)	借款成本

國際會計準則第1號(修訂版)要求分開披露所有者權益和非所有者權益變動表。所有者權益變動表將包括與公司所有者之間的交易和非所有者之前的交易所引起的權益變動單行列示。此外，該準則引入綜合收益報表：報表編製者可選擇將所有的收入、費用項目以及其他綜合收益的組成部分放入同一張綜合收益報表或者放入兩張連接的報表。本公司仍在評估是否採用一張或兩張報表。

國際財務報告準則第8號將會影響公司對經營性分部、主要產品及服務、經營之地理區域、及其主要客戶之披露。

國際會計準則第23號(修訂版)取消了將須經過頗長時間方可作原定用途或銷售之資產的借貸成本直接費用化的選擇權。

國際財務報告準則第8號將取代國際財務報告準則第14號，並自2009年1月1日或以後日期開始之會計年度生效。國際會計準則第1號(修改版)和國際會計準則第23號(修改版)適用於2009年1月1日或之後開始之會計期間。

除上述外，本公司預期採用上述準則將不會對本公司的財務狀況及經營成果產生重大影響。

### 3. 分類資料

本公司之營業額及溢利主要來自晶圓銷售。本公司僅有一個業務類別。

本公司主要資產位於中國上海，因此，並未對本公司資產地理位置提供分類資料。

本公司營業額乃按客戶所在地進行地理分區。基於客戶所在地之營業額地區分類資料列示如下：

	截至2008年 6月30日止 三個月 (未審數) 人民幣千元	截至2008年 6月30日止 六個月 (未審數) 人民幣千元	截至2007年 6月30日止 三個月 (未審數) 人民幣千元	截至2007年 6月30日止 六個月 (未審數) 人民幣千元
美國	136,019	250,483	169,063	307,195
歐洲	69,673	163,779	64,463	135,459
亞洲	54,892	104,630	37,663	136,798
	<u>260,584</u>	<u>518,892</u>	<u>271,189</u>	<u>579,452</u>

### 4. 營業額

	截至2008年 6月30日止 三個月 (未審數) 人民幣千元	截至2008年 6月30日止 六個月 (未審數) 人民幣千元	截至2007年 6月30日止 三個月 (未審數) 人民幣千元	截至2007年 6月30日止 六個月 (未審數) 人民幣千元
營業額				
貨物銷售	260,498	518,776	270,880	579,129
其他	86	116	309	323
	<u>260,584</u>	<u>518,892</u>	<u>271,189</u>	<u>579,452</u>

## 5. 其他收入和其他費用

	截至2008年 6月30日止 三個月 (未審數) 人民幣千元	截至2008年 6月30日止 六個月 (未審數) 人民幣千元	截至2007年 6月30日止 三個月 (未審數) 人民幣千元	截至2007年 6月30日止 六個月 (未審數) 人民幣千元
<b>其他收入</b>				
停電損失賠償	43,500	43,500	—	—
利息收入(按歷史成本法)	7	2,089	3,726	9,150
淨匯兌(損失)/收益	(284)	384	3,381	5,795
利率互換上的公允 價值收益/(虧損)	826	(415)	245	(281)
其他	1,276	2,869	1,052	1,272
	<u>45,325</u>	<u>48,427</u>	<u>8,404</u>	<u>15,936</u>
<b>其他費用</b>				
在2007年第四季度停電中受損的				
機器設備備件替換費用	(2,997)	(10,090)	—	—
捐贈	(500)	(500)	—	—
	<u>(3,497)</u>	<u>(10,590)</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

## 6. 除所得稅前之溢利/(虧損)

除所得稅前之溢利/(虧損)已扣除下列各項：

	截至2008年 6月30日止 三個月 (未審數) 人民幣千元	截至2008年 6月30日止 六個月 (未審數) 人民幣千元	截至2007年 6月30日止 三個月 (未審數) 人民幣千元	截至2007年 6月30日止 六個月 (未審數) 人民幣千元
銀行貸款利息	4,522	10,391	10,593	24,161
折舊	56,679	113,999	95,788	194,023
存貨跌價準備(轉回)/計提	(848)	(5,627)	8,114	12,725
物業、廠房及設備處置損益	191	917	—	697
物業、廠房及設備減值準備轉回	—	(322)	—	—
	<u>50,544</u>	<u>118,358</u>	<u>109,495</u>	<u>231,606</u>

## 7. 稅項

由於本公司截至2007年、2008年6月30日止三個月及六個月並無在香港獲得任何應課稅溢利，因此並無就香港利得稅作出準備。

所得稅退款淨額主要構成如下：

	截至2008年 6月30日止 三個月 (未審數) 人民幣千元	截至2008年 6月30日止 六個月 (未審數) 人民幣千元	截至2007年 6月30日止 三個月 (未審數) 人民幣千元	截至2007年 6月30日止 六個月 (未審數) 人民幣千元
本期就溢利所作出 之所得稅準備				
— 當期	—	—	—	—
— 遞延稅項	—	—	(17,969)	(19,713)
所得稅退款	—	—	(17,969)	(19,713)

## 8. 股息

董事會建議不派發截至2008年6月30日止三個月及六個月股息(截至2007年6月30日止六個月：無)。

## 9. 普通股股東每股盈利／(虧損)

每股基本盈利／(虧損)乃按本公司普通股股東應佔淨盈利／(虧損)除以於相應期間內加權平均發行在外之股數計算。

	截至2008年 6月30日止 三個月 (未審數)	截至2008年 6月30日止 六個月 (未審數)	截至2007年 6月30日止 三個月 (未審數)	截至2007年 6月30日止 六個月 (未審數)
普通股股東盈利／(虧損) (人民幣'000)	19,890	(6,574)	(35,446)	(72,955)
加權平均普通股股本 (千股)	1,534,227	1,534,227	1,534,227	1,534,227

因無導致每股盈利／(虧損)攤薄之事項存在，故於截至2008年及2007年6月30日止六個月經攤薄之每股盈利／(虧損)未作披露。

10. 應收貿易賬款及應收票據

	2008年 6月30日 (未審數) 人民幣千元	2007年 12月31日 (已審數) 人民幣千元
應收賬款	104,290	82,300
應收票據	8,789	1,478
	<u>113,079</u>	<u>83,778</u>

本公司提供給客戶的信用期限一般為30天到60天。

本公司應收貿易賬款及應收票據的帳面金額約相當於公允價值。

截至2008年6月30日的應收貿易賬款的賬齡分析如下：

	2008年 6月30日 (未審數) 人民幣千元	2007年 12月31日 (已審數) 人民幣千元
按賬齡分類之餘額：		
30天內	61,886	55,485
31天至90天	39,914	16,947
91天至180天	824	7,333
181天至365天	1,666	2,535
	<u>104,290</u>	<u>82,300</u>
減：呆壞賬準備	—	—
	<u>104,290</u>	<u>82,300</u>

2008年6月30日到期但未減值的應收貿易賬款帳齡分析如下：

	合計 人民幣千元	既未到期 又未減值 人民幣千元	已到期但未減值		
			<60天 人民幣千元	60—180天 人民幣千元	181—365天 人民幣千元
2008年6月30日	104,290	68,015	34,229	928	1,118
2007年12月31日	82,300	61,383	11,070	9,683	164

## 11. 應付貿易賬款

	2008年 6月30日 (未審數) 人民幣千元	2007年 12月31日 (已審數) 人民幣千元
按賬齡分類之餘額：		
30天內	93,485	146,669
31天至90天	12,192	12,978
91天至180天	4,362	6,361
181天至365天	1,849	1,147
超過365天	3,247	4,525
	<u>115,135</u>	<u>171,680</u>

本公司應付貿易賬款的帳面金額約相當於公允價值。

### 管理層討論及分析

截至二零零八年六月三十日止六個月與截至二零零七年六月三十日止六個月的比較

#### 銷售額

截至二零零八年六月三十日止六個月期間，本公司經營遭遇了全球經濟放緩，傳統市場淡季及因配合內部年度檢修所實施停產等不利因素影響。因此，截至二零零八年六月三十日止六個月的本公司銷售額為人民幣5.189億元，較截至二零零七年六月三十日止六個月的銷售額人民幣5.795億元下降10.5%。在報告期內，本公司8英寸等值晶圓的交付量較截至二零零七年六月三十日止六個月的221,514片減少4.9%至210,597片。

#### 銷售成本及毛利

截至二零零八年六月三十日止六個月的本公司毛利為人民幣1,610萬元，毛利率為3.1%，截至二零零七年六月三十日止六個月的毛利為人民幣負2,370萬元，毛利率為負4.1%，毛利率上升主要源於截至二零零七年十二月三十一日之財務年度實施了8英寸晶圓資產減值致使報告期內的折舊費用降低人民幣7,520萬元，最終反映在銷售成本減少人民幣6,850萬元。

## 經營費用及經營收益

截至二零零八年六月三十日止六個月銷售及市場推廣開支由截至二零零七年六月三十日止六個月的銷售及市場推廣開支人民幣430萬元下降至人民幣320萬元，主要源於薪資相關費用支出減少和銷售佣金率下降。

截至二零零八年六月三十日止六個月行政開支為人民幣3,800萬元，與截至二零零七年六月三十日止六個月的行政開支人民幣3,620萬比較，增幅為5.0%。

截至二零零八年六月三十日止六個月研發成本為人民幣880萬元，與截至二零零七年六月三十日止六個月的研發成本人民幣2,030萬元相比，下降56.7%，主要因報告期內的工程晶圓出售增加致使相關研發費用降低。

因此，本公司截至二零零八年六月三十日止六個月的經營業務虧損為人民幣3,400萬元，截至二零零七年六月三十日止六個月的經營業務虧損為人民幣8,440萬元。本公司截至二零零八年六月三十日止六個月的經營毛利率為負6.6%，截至二零零七年六月三十日止六個月的經營毛利率為負14.6%。

## 其他開支、其他收入及融資成本

截至二零零八年六月三十日止六個月其他開支為人民幣1,100萬元。本報告期內的其他開支主要包括二零零七年第四季度因停電引起的固定資產備件更換和利率掉期公允價值虧損及為四川地震捐贈。截至二零零七年六月三十日止六個月利率掉期公允價值虧損約人民幣30萬元列入在當期的其他收入而非在其他開支中。

本公司截至二零零八年六月三十日止六個月的其他收入由去年同期的人民幣1,590萬元增加至人民幣4,880萬元，主要是源於停電保險賠償大幅增加，並部分被同期利息收入及淨匯兌收益減少所抵消。

本公司截至二零零八年六月三十日止六個月的融資成本為人民幣1,040萬元，較截至二零零七年六月三十日止六個月的融資成本人民幣2,420萬元下降57.0%，主要為本公司銀行貸款餘額降低導致利息支出減少。

## 淨利潤

綜上所述，本公司截至二零零八年六月三十日止六個月的淨虧損為人民幣660萬元，截至二零零七年六月三十日止六個月的淨虧損為人民幣7,300萬元。

## 流動資金及資金來源

於二零零八年六月三十日及二零零七年十二月三十一日，本公司的現金及現金等價物分別為人民幣2.298億元和人民幣2.070億元。截至二零零八年六月三十日止，本公司的經營業務之現金流入淨額為人民幣1.099億元，截至二零零七年六月三十日止的經營業務之現金流入淨額人民幣3,850萬元。

本公司的投資活動現金流出淨額主要用於對物業、廠房、設備以及在建工程的持續投資。截至二零零八年六月三十日，本公司的資本開支淨額為人民幣590萬元。去年同期的資本開支淨額為人民幣330萬元。大部分資本開支用於提高和改善6英寸和8英寸晶圓設施的靈活性和運行效率。

截至二零零八年六月三十日止六個月本公司的融資活動現金流出淨額為人民幣8,110萬元，截至二零零七年六月三十日止六個月本公司的融資活動現金流出淨額為人民幣3.714億元。前者主要是在報告期內由於償還銀行貸款人民幣1.111億元和新增銀行貸款人民幣3,000萬元。在今年上半年及去年同期，本公司僅依託銀行貸款來從事經營活動。

於二零零八年六月三十日，本公司短期付息借款餘額為人民幣2.692億元，其中1億美元銀團長期貸款協定中未償還貸款約為1,170萬美元（相當於人民幣約8,030萬元）。根據長期貸款協定，本公司於二零零八年七月一日提前償還其中貸款1,000萬美元。因此，剩餘170萬美元將於二零零八年九月三十日前全部還清。根據二零零五年三月三十一日所簽署之1億美元長期借款規定，未償還貸款由本公司物業、廠房及設備、在建工程和土地使用權作抵押。

在報告期內，本公司達到了1億美元銀團長期貸款中規定的相關財務指標。

截至二零零八年六月三十日止，本公司的流動比率為1.22，截至二零零七年十二月三十一日止為0.99。本公司的總負債與股東權益之比由二零零七年十二月三十一日止的14.7%改善至二零零八年六月三十日之4.1%。

## 員工

截至二零零八年六月三十日止，本公司聘用1,734名員工，與截至二零零七年十二月三十一日止的1,847員工相比，員工數下降6.1%。本公司在報告期內與其員工維持著良好工作關係並按照中國相關法規和政策為員工提供和支付報酬和福利。

## 利率風險

本公司付息貸款和借款受倫敦銀行同業拆息及利差影響。鑒於本公司債務中大部分是美元債,公司盈利能力受制於倫敦銀行同業拆借美元利息波動所引發的利率風險。本公司對本金1,380萬美元應付利息訂立利率掉期,以對沖利率波動風險。

## 人民幣波動風險

由於人民幣是中國(本公司經營所在地的主要經濟環境)的法定貨幣,本公司的功能性和申報貨幣為人民幣。本公司收入和支出中有很大大金額是外幣。如果本公司的人民幣收入不足以支付人民幣支出,則需要將外幣轉換為人民幣來彌補差額,在轉換中可能引起匯兌虧損,直至導致對本公司現金流量產生負面影響。在報告期內,本公司未運用金融衍生工具規避人民幣升值。

## 資本承諾

截至二零零八年六月三十日止,本公司購買物業、廠房、設備的資本承諾為人民幣4,600萬元,其中人民幣1,680萬元為已訂約但未撥備,人民幣2,920萬元為已授權但未訂約。

## 二零零八年第二季度業績回顧

二零零八年第二季度銷售額為人民幣2.606億元,相比二零零八年第一季度銷售額人民幣2.583億元,環比增加1.0%,主要源於8英寸晶圓銷售大幅增加,且部分為5英寸和6英寸晶圓銷售下降所抵消。

二零零八年第二季度毛利為人民幣490萬元,二零零八年第一季度毛利為人民幣1,120萬元,二零零八年第二季度毛利率環比下降2.4%至1.9%,主要是為維護5英寸和6英寸晶圓廠持續穩定運行所引發較高維修成本所致。

二零零八年第二季度營業開支為人民幣2,230萬元，較二零零八年第一季度營業開支人民幣2,780萬元下降19.8%，主要歸因於研發費用及行政開支下降，且部分為銷售及市場推廣開支上升所抵消。

二零零八年第二季度其他收入和融資成本為人民幣4,000萬元，二零零八年第一季度其他收入和融資成本為人民幣負150萬元，主要源於較高其他收入和較低融資成本。第二季度其他收入為人民幣4,450萬元，第一季度為人民幣430萬元，主要源於獲得停電保險賠償，並部分為利息收入減少及匯兌虧損所抵消。第二季度融資成本較第一季度下降主要由於第二季度的利息支出減少所致。

截至二零零八年六月三十日止之三個月其他開支為人民幣270萬元，截至二零零八年三月三十一日止之三個月其他費用為人民幣830萬元。本季度的其他開支下降主要因二零零七年第四季度因停電引起的固定資產備件更換減少，且部分為利率掉期公允價值收益所抵消。

因此，二零零八年第二季度淨利潤為人民幣1,990萬元，二零零八年第一季度淨虧損為人民幣2,650萬元。

## 1 · 營業額分析

### 用途

二零零八年第二季度本公司在通訊，電腦，消費品方面的營業額分別佔總收入的32%，32%和36%，與第一季度基本持平。

	08第二季度	08第一季度	07第二季度
通訊	32%	32%	33%
電腦	32%	33%	33%
消費品	36%	35%	34%

## 地區

二零零八年第二季度本公司在北美的銷售佔總收入的52%，上季度為43%，主要因來自一家位於美國的客户銷售額環比上升約144%。同樣，歐洲的銷售佔總收入的27%，上季度為36%。亞太地區的銷售佔總收入的21%，與上季度持平。

	08第二季度	08第一季度	07第二季度
美國	52%	43%	62%
歐洲	27%	36%	24%
亞太地區	21%	21%	14%

## 客戶類型

二零零八年第二季度集成器件製造商和無生產線半導體公司的銷售佔總收入分別為37%和63%。

	08第二季度	08第一季度	07第二季度
集成器件製造商	37%	45%	34%
無生產線半導體公司	63%	55%	66%

## 產品

5英寸、6英寸和8英寸於二零零八年第二季度銷售佔總收入分別為18%、50%和31%，上季度分別為23%、54%和22%。

	08第二季度	08第一季度	07第二季度
5英寸晶圓	18%	23%	13%
6英寸晶圓	50%	54%	53%
8英寸晶圓	31%	22%	32%
其他 <sup>1</sup>	1%	1%	2%
總計	100%	100%	100%

備註1：包括測試服務及掩膜提供

## 2 · 利用率和產能 (8英寸等值晶圓)

### 2.1 利用率

二零零八年第二季度總體產能利用率為66%，二零零八年第一季度為59%。

晶圓製造廠	08第二季度	08第一季度	07第二季度
1/2號晶圓製造廠			
5英寸晶圓	64%	75%	43%
6英寸晶圓	74%	73%	74%
3號晶圓製造廠			
8英寸晶圓	57%	37%	55%
總體產能利用率	66%	59%	62%

備註：產能利用率指報告期內由裝運的半導體晶圓加工程式實際數(以掩膜層數計算)除以晶圓製造廠可在相應期間內提供加工程式數百分比。

### 2.2 產能 (8英寸等值晶圓)

二零零八年第二季度生產8英寸等值晶圓的產能為154千片,與二零零八年第一季度和二零零七年第二季度相同。

晶圓製造廠 (千片晶圓)	08第二季度	08第一季度	07第二季度
1/2號晶圓製造廠			
5英寸晶圓	33	33	33
6英寸晶圓	85	85	85
3號晶圓製造廠			
8英寸晶圓	36	36	36
總體產能	154	154	154

備註：5英寸、6英寸和8英寸的產能分別以每片晶圓9、10和22 Mask層數估算。5、6英寸晶圓需將晶圓片除以2.56和1.78，以換算成8英寸等值晶圓。

### 3 · 應收賬款／存貨周轉率

二零零八年第二季度應收賬款及票據周轉天數為43天，上季度39天。

二零零八年第二季度存貨周轉天數由上季度80天下降至67天，主要因原材料和成品庫存水平下降所致。

	08第二季度	08第一季度	07第二季度
應收賬款及票據周轉率(天數)	43	39	54
存貨周轉率(天數)	67	80	73

### 4 · 資本支出

二零零八年第二季度資本支出為人民幣550萬元，第一季度為人民幣40萬元。

	08第二季度	08第一季度	07第二季度
資本支出	5,546	393	1,445

(金額：人民幣千元)

### 前景及未來計畫

鑒於全球經濟放緩和美國經濟衰退之預期，加之因全球食品和燃料價格上漲所引發日益增加的通貨膨脹壓力及未來季節出現低於正常傳統季節性表現預期，這可能會進一步抑制全球範圍內客戶對半導體相關產品消費支出。因此，管理層預計半導體行業近期仍會繼續面臨相當之挑戰。

面對不利的宏觀環境，本公司會通過繼續致力於以8英寸晶圓為主新業務開發及現有產能脫瓶頸工作來進一步增強其業務運作基礎。作為公司業務策略重要組成部分，本公司與恩智浦合作的6英寸晶圓產能擴建專案正按計劃進行之中。該專案竣工之後，將提升公司6英寸晶圓產能，最終有助創造新的收入來源。此外，

本公司將繼續通過與其現有客戶及新客戶緊密合作來加快8英寸晶圓產品設計和模具建立、產品認證、試產及規模生產進程,並就客戶未來產品技術發展趨勢與其更好結盟從而為其客戶創造價值,最終實現其股東價值最大化。

本公司未來將密切關注半導體行業發展,來完善制定其業務策略和未來發展規劃以迅速應對日益變化的市場狀況和行業內快速技術進步,使公司未來進一步增強其競爭能力和獲得可持續發展和增長,鞏固其作為一家專門模擬代工製造商之領先地位。

### **購買、出售或贖回本公司的上市證券**

截至二零零八年六月三十日止六個月,本公司概無購買、出售或贖回任何本公司的上市證券。

### **企業管治**

#### **遵守企業管治常規守則(「管治守則」)**

本公司承諾維持高水準的企業管治,以便確保提高透明度以及對股東利益的保護。截至二零零八年六月三十日的六個月期間內,本公司完全遵守上市規則附錄14載列的管治守則。

#### **標準守則**

本公司已採納標準守則作為公司董事和監事進行證券交易的行為守則。

本公司經向所有董事和監事作出具體查詢後,確認所有董事和監事於截至二零零八年六月三十日止的六個月中,均已遵守標準守則所規定的標準。

## 經審計委員會審閱

本公司審計委員會包括三位獨立非執行董事，James Arthur Watkins先生（主席）、Thaddeus Thomas Beczak先生和沈偉家先生，以及兩位非執行董事，Petrus Antonius Maria Van Bommel先生和諸培毅先生。本公司截至二零零八年六月三十日止六個月的中期業績未經審計，但已經由審計委員會及公司的外部審計安永會計師事務所審閱。

承董事會命  
上海先進半導體製造股份有限公司  
執行董事及首席財務長  
程堅玉

中國上海，二零零八年八月二十二日

於本公佈日期，本公司以呂學正和程堅玉為執行董事；以陳建明、諸培毅、朱健、肖永吉、Hendricus Cornelis Maria van der Zeeuw及Petrus Antonius Maria van Bommel為非執行董事；及以Thaddeus Thomas Beczak、沈偉家及James Arthur Watkins為獨立非執行董事。